

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI
(c) 2002 Derwent Info Ltd. All its. reserv.
011786592 **Image available**
WPI Acc No: 1998-203502/199818
XRPX Acc No: N98-162212

Baking apparatus for semiconductor device manufacture - has process chamber in which circulation of inert gas corresponding to heating substrate area is carried out through heating unit and is ejected out through lower part of chamber

Patent Assignee: SONY CORP (SONY)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 10055951	A	19980224	JP 96212753	A	19960812	199818 B

Priority Applications (No Type Date): JP 96212753 A 19960812

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 10055951	A		7 H01L-021/027	

Abstract (Basic): JP 10055951 A

The apparatus has a process chamber (11) in which a wafer (10) coated with specific resist pattern, to be baked is arranged. The baking of substrate is carried out, after performing exposure process. During baking, inert gas is supplied to the process chamber through a pipe line (31) arranged at the lower part of the chamber.

The amount of gas flow is regulated by a regulator (34) attached to the pipe line. The inert gas is heated by a heater (35) arranged at the pipe line. The inert gas is made to pass through a blowing pore of a heating unit (5a). The inert gas is guided to the inner side of the chamber from upper side to circumferential side of a heating substrate. The circulated gas is ejected out through lower part of the chamber.

ADVANTAGE - Simplifies semiconductor device manufacture.

Facilitates homogeneous heat treatment of wafer.

Dwg.1/6

Title Terms: BAKE; APPARATUS; SEMICONDUCTOR; DEVICE; MANUFACTURE; PROCESS; CHAMBER; CIRCULATE; INERT; GAS; CORRESPOND; HEAT; SUBSTRATE; AREA; CARRY; THROUGH; HEAT; UNIT; EJECT; THROUGH; LOWER; PART; CHAMBER

Derwent Class: U11

International Patent Class (Main): H01L-021/027

File Segment: EPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05772851 **Image available**

BAKING DEVICE AND METHOD

PUB. NO.: 10-055951 [JP 10055951 A]

PUBLISHED: February 24, 1998 (19980224)

INVENTOR(s): YOSHIZAWA NORITSUGU

APPLICANT(s): SONY CORP [000218] (A Japanese Company or Corporation), JP
(Japan)

APPL. NO.: 08-212753 [JP 96212753]

FILED: August 12, 1996 (19960812)

INTL CLASS: [6] H01L-021/027

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 36.1 (LABOR
SAVING DEVICES -- Industrial Robots)

JAPIO KEYWORD: R002 (LASERS); R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the baking device and method capable of heat treatment making no difference in on surface heat history by equalizing the on surface temperature of semiconductor wafer in the PEB (Post Exposure Bake) step within the resist step using chemical amplification type resist.

SOLUTION: A gas flow rate adjuster 34 and a gas heater 35 are provided in a gas piping system 31 of an inert gas led from the lower part into a processing chamber 11 of a heating part 5a of a PEB device. In such a constitution, a semiconductor device is heated by a heating part provided with a blowout hole 32 blowing out an inert gas from the peripheral part of a heating substrate 12 heating a mounted semiconductor wafer 10 to the surface side of the heating substrate later shifting the semiconductor wafer 10 to the cooling part of the PEB device to be cooled down. Through these procedures, a high integrated semiconductor device can be manufactured.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-55951

(43) 公開日 平成10年(1998) 2月24日

(51) Int. Cl. ⁶

H01L 21/027

識別記号

F I

H01L 21/30

568

566

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平8-212753

(22) 出願日 平成 8 年(1996) 8月12日

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号

(72) 発明者 吉沢 規次

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニ

ー株式会社内

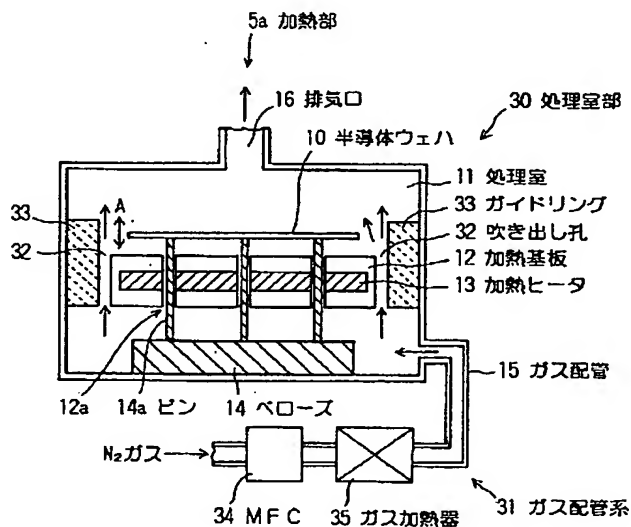
(54) 【発明の名称】 ベーキング装置およびベーキング方法

(57) 【要約】

【課題】 化学増幅型レジストを使用するレジスト工程における、PEB工程時の半導体ウェハ面内温度を均一化して面内熱履歴差異の無い熱処理を可能にするベーキング装置およびベーキング方法を提供する。

【解決手段】 PEB装置の加熱部 5a の処理室 11 下方より処理室 11 内に導入する不活性ガスのガス配管系 31 にガス流量調整器 34 とガス加熱器 35 を設け、半導体ウェハ 10 を載置して加熱する加熱基板 12 周縁部より加熱基板上面側に不活性ガスを吹き出ださせる吹き出し孔 32 を設けた加熱部により、半導体ウェハ 10 を加熱し、その後半導体ウェハ 10 をPEB装置の冷却部に移動させて冷却する。

【効果】 高集積化した半導体装置の製造が可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 化学増幅型レジストを塗布した被処理基板の露光後にベーキングをする、加熱部と冷却部とを有して構成されたベーキング装置において、

前記加熱部の処理室下方より処理室内に導入する不活性ガスのガス配管系にガス流量調整器とガス加熱器を設け、

前記処理室下方より前記処理室内に導入する前記不活性ガスを、前記被処理基板を載置して加熱する加熱基板周縁部より加熱基板上面側に吹き出させる吹き出し孔を設けた加熱部を有することを特徴とするベーキング装置。

【請求項 2】 前記冷却部の処理室下方より処理室内に導入する不活性ガスのガス配管系にガス流量調整器とガス冷却器を設け、

前記処理室下方より前記処理室内に導入する前記不活性ガスを、前記被処理基板を載置して冷却する冷却基板周縁部より冷却基板上面側に吹き出させる吹き出し孔を設けた冷却部を有することを特徴とする請求項 1 に記載のベーキング装置。

【請求項 3】 前記加熱基板周縁部に設けた前記吹き出し孔は、前記加熱基板周縁部に沿って、略等しい幅を持って設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載のベーキング装置。

【請求項 4】 前記冷却基板周縁部に設けた前記吹き出し孔は、前記冷却基板周縁部に沿って、略等しい幅を持って設けられていることを特徴とする請求項 2 に記載のベーキング装置。

【請求項 5】 請求項 1 に記載のベーキング装置を用いた、化学増幅型レジストを塗布した被処理基板の露光後のベーキング方法において、

所定流量、所定温度の不活性ガスを、前記ベーキング装置の加熱部の処理室に導入する工程と、

前記加熱部の加熱基板を所定温度にする工程と、

前記加熱部の前記加熱基板上に前記被処理基板を載置し、所定時間熱処理する工程と、

前記加熱部の前記加熱基板上の前記被処理基板を取り出し、前記ベーキング装置の冷却部の冷却基板上に載置して前記被処理基板を冷却する工程とを有すること、

を特徴とするベーキング方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】本発明はベーキング装置およびベーキング方法に関し、さらに詳しくは、半導体装置の製造における、化学増幅型レジスト使用のフォトリソグラフィ工程で用いられる PEB (Post Exposure Bake) 装置と言われるベーキング装置およびベーキング方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】近年、半導体装置の高集積化に伴い、回

路パターンを微細化する技術が要求されている。このため、フォトリソグラフィ技術にあっては、短波長の露光光源や高 N A を持つ照明レンズ系による高解像度の露光装置の開発、高解像度で高感度のフォトリソグラフィ等の開発が盛んに行われている。特に、クォータミクロン程度のパターン形成には、A r F エキシマレーザや K r F エキシマレーザ等の光源を用い、化学増幅型レジストといわれるフォトリソグラフィ技術を用いたフォトリソグラフィ技術が盛んに使用されている。

【 0 0 0 3 】この化学増幅型レジストには、ポジ型とネガ型があり、例えばポジ型は、フェノール系樹脂に感光性酸発生剤と架橋剤若しくは溶解阻止剤が配合されているものである。このフォトリソグラフィを露光すると、感光性酸発生剤から分解生成した酸が、その後の露光後のベーク、即ち PEB (Post Exposure Bake) により拡散し、架橋剤若しくは溶解阻止剤を攻撃して離脱反応を生じせしめ、その結果フェノール系樹脂の水酸基が発現して露光部がアルカリ可溶性となる。そしてこの反応は、酸を触媒として連鎖的に進行するので、化学増幅型レジストはきわめて高感度のフォトリソグラフィとなる。

【 0 0 0 4 】一方、この化学増幅型レジストは、触媒となる酸が極めて微量であり、パターニングの安定性、例えば線幅安定性は、レジスト工程での処理条件のわずかな変動や雰囲気等により大きな影響を受ける。この変動要因としては、レジスト工程のレジスト塗布、露光、露光後の雰囲気、露光後の PEB、現像等に潜んでいるが、特に露光後の雰囲気と露光後の PEB における要因が大である。それは、露光後の雰囲気中に僅かな塩基性物質があると、露光により発生した酸が失活して触媒としての効力を失うためである。また、露光により発生した酸を触媒とするフォトリソグラフィの化学反応は、露光後の PEB による熱処理で促進されるもので、この熱処理条件の変動がパターニングの変動を起こすためである。

【 0 0 0 5 】次に、この化学増幅型レジストを用いた従来のレジスト工程およびこのレジスト工程に使用される PEB 装置に関して、図 3 ～ 図 6 を参照して説明する。まず、レジスト工程は、図 3 に示すように、半導体ウェハが収納されたウェハカセットを設置するウェハ供給部 1 より、半導体ウェハを一枚ずつレジスト塗布部 2 に自動搬送で送られる。レジスト塗布部 2 で半導体ウェハ上に、上述した化学増幅型レジストが塗布され、レジストが塗布された半導体ウェハは、自動搬送により、プリベーク部 3 に送られる。プリベーク部 3 でプリベークされた半導体ウェハは、露光装置 4 に自動搬送され、露光装置 4 で露光される。

【 0 0 0 6 】露光された半導体ウェハは、直ちに PEB 装置 5 の加熱部 5 a に自動搬送され、所定温度で所定時間だけ正確に加熱され、その後ロボットアーム等で直ちに冷却部 5 a へ送られ冷却される。この加熱より冷却ま

での熱履歴が常に所定の熱履歴を再現しないと、パターニングの安定性が悪くなる。冷却された半導体ウェハは、現像部 6 に自動搬送されて、フォトリソが現像され、その後半導体ウェハを収納するウェハカセットが設置されているウェハ収納部 8 に自動搬送され、ウェハカセットに一枚ずつ収納される。

【 0 0 0 7 】次に、このレジスト工程で使用される P E B 装置の詳細を説明する。P E B 装置は、上述した如く、加熱部 5 a と冷却部 5 b で構成されていて、露光装置 1 より自動搬送されてきた半導体ウェハは、自動搬送部と加熱部 5 a 間、加熱部 5 a と冷却部 5 b 間、冷却部 5 b と現像部 6 側の自動搬送部間をロボットアーム（図示省略）等によって移動するようになっている。このロボットアーム等の使用による半導体ウェハの迅速な移動が、半導体ウェハの所定の熱履歴を正確に再現する上で必要となる。

【 0 0 0 8 】P E B 装置の加熱部 5 a は、図 4 に示すような構成になっている。即ち加熱部 5 a は、処理室 1 1 内に加熱ヒータ 1 3 を内蔵し、半導体ウェハを載置する加熱基板 1 2 と、駆動機構（図示省略）により上下移動するベローズ 1 4 と、このベローズ 1 4 の上面に設けられ、加熱基板 1 2 に穿設された複数個、例えば 3 個の貫通孔 1 2 a にそれぞれ挿通したピン 1 4 a とにより概略構成されている。上述したピン 1 4 a は、ベローズ 1 4 の上面の上下移動でベローズ 1 4 上面が最上位になった時は、ピン 1 4 a の上端は加熱基板 1 2 上面より突出する。この状態で、ロボットアーム（図示省略）による半導体ウェハ 1 0 の搬入搬出が行われる。

【 0 0 0 9 】一方、ベローズ 1 4 の上面の上下移動で最下位になった時は、ピン 1 4 a の上端は貫通孔 1 2 a 内に没入し、ピン 1 4 a 上端に支持された半導体ウェハ 1 0 は矢印 C の下方に移動して加熱基板 1 2 上面に載置され、半導体ウェハ 1 0 の加熱処理が開始される。

【 0 0 1 0 】なお、ベローズ 1 4 の上面に設けられ 3 個のピン 1 4 a は、加熱基板 1 2 に半導体ウェハ 1 0 を載置した上面図である図 5 に示すように、半導体ウェハ 1 0 周縁部の内側の同心円上に等間隔で設け、半導体ウェハ 1 0 を安定に支えられるようになっている。また、処理室 1 1 内には、塩基性物質を含まない不活性ガス、例えば N₂ ガスがガス配管 1 5 より常時導入され、ガス排気口 1 6 より排出されている。

【 0 0 1 1 】一方、P E B 装置の冷却部 5 b は、図 6 に示すように、処理室 2 1 内に、冷却水が流れる中空部 2 3 を持ち、この中空部 2 3 には冷却水の配管 2 4 が接続する冷却基板 2 2 と、駆動機構（図示省略）により上下移動するベローズ 2 5 と、このベローズ 2 5 の上面に設けられ、冷却基板 2 2 に穿設された複数個、例えば、3 個の貫通孔 2 2 a にそれぞれ挿通した 3 個のピン 2 5 a とにより概略構成されている。ベローズ 2 5 上面に穿設したピン 2 5 a が冷却基板 2 2 上面より突出した状態

で、ロボットアームにより送られてきた、加熱された半導体ウェハ 1 0 がピン 2 5 a 上端に載置され、ベローズ 2 5 の下方への移動により、半導体ウェハ 1 0 は矢印 D の下方に移動して冷却基板 2 2 上に載置され、冷却開始状態となる。また、処理室 2 1 内には、塩基性物質を含まない不活性ガス、例えば N₂ ガスがガス配管 2 6 より常時導入され、ガス排気口 2 7 より排出されている。

【 0 0 1 2 】上述した加熱部 5 a と冷却部 5 b とで構成される P E B 装置により、所定の熱履歴による正確な P E B を行うことで、現像されて形成されるフォトリソパターン線の線幅安定化を図っている。

【 0 0 1 3 】しかしながら、上述した P E B 装置では、半導体ウェハ 1 0 の加熱時に半導体ウェハ 1 0 面内の中心部と周辺部とでは温度差があり、また加熱した半導体ウェハ 1 0 の冷却時に半導体ウェハ 1 0 面内の中心部と周辺部とでの冷却速度に差がある。従って、半導体ウェハ 1 0 の中心部と周辺部とでは、熱履歴が異なってしまう、半導体ウェハ 1 0 全面を所定の熱履歴の熱処理を行わせることが困難となる。化学増幅型レジストを使用する場合は、所定の熱履歴の熱処理を正確に行わせないと、所望のパターニング精度が得られないので、上述のような半導体ウェハ 1 0 の面内熱履歴の差異は、パターニングした線幅にばらつきが発生するという問題が生じる。

【 0 0 1 4 】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述したベーク装置およびベーク方法における問題点を解決することをその目的とする。即ち本発明の課題は、化学増幅型レジストを使用するレジスト工程における、P E B 工程時の半導体ウェハ面内温度を均一化して面内熱履歴差異の無い熱処理を可能にするベーク装置およびベーク方法を提供することを目的とする。

【 0 0 1 5 】

【課題を解決するための手段】本発明のベーク装置およびベーク方法は、上述の課題を解決するために提案するものである。即ち本発明のベーク装置は、化学増幅型レジストを塗布した被処理基板の露光後にベークをする、加熱部と冷却部とを有して構成されたベーク装置において、加熱部の処理室下方より処理室内に導入する不活性ガスのガス配管系にガス流量調整器とガス加熱器を設け、処理室下方より処理室内に導入する不活性ガスを、被処理基板を載置して加熱する加熱基板周縁部より加熱基板上面側に吹き出させる吹き出し孔を設けた加熱部を有することを特徴とするものである。

【 0 0 1 6 】本発明のベーク方法は、請求項 1 に記載のベーク装置を用いた、化学増幅型レジストを塗布した被処理基板の露光後のベーク方法において、所定流量、所定温度の不活性ガスを、ベーク装置の加熱部の処理室に導入する工程と、加熱部の加熱基板を

所定温度にする工程と、加熱部の加熱基板上に被処理基板を載置し、所定時間熱処理する工程と、加熱部の加熱基板上の被処理基板を取り出し、ベーキング装置の冷却部の冷却基板上に載置して被処理基板を冷却する工程とを有することを特徴とするものである。

【0017】本発明によれば、ベーキング装置の加熱部の処理室下方より、所定流量および所定温度の不活性ガスを導入し、加熱基板周縁部に設けた不活性ガスの吹き出し孔より、加熱基板上面の中央上方部に吹き出させることで、加熱基板上に載置された被処理基板の周辺部の温度低下を抑えられ、被処理基板の温度均一化が図れる。従って化学増幅型レジストを用いた微細化したパターンは、被処理基板面内での線幅バラツキがほとんど無い状態で形成でき、高集積化した半導体装置の製造が可能となる。

【0018】

【発明の実施の形態】以下、本発明の具体的実施の形態例につき、添付図面を参照して説明する。なお従来技術の説明で参照した図3～図6中の構成部分と同様の構成部分には、同一の参照符号を付すものとする。

【0019】本実施の形態例は、化学増幅型レジストを使用するレジスト工程における、PEB工程のベーキング装置およびベーキング方法に本発明を適用した例であり、これを図1および図2を参照して説明する。化学増幅型レジストを使用するレジスト工程は、図3を参照して説明した従来例と同様なので説明を省略し、このレジスト工程におけるPEB工程で使用するベーキング装置およびベーキング方法を以下に説明する。

【0020】まず、PEB装置の加熱部5aは、図1に示すように、処理室部30と、処理室11内の雰囲気を入換する不活性ガス、例えばN₂ガスを導入するための、不活性ガスを導入するガス配管系31とで概略構成されている。加熱部5aの処理室部30は、処理室11内に加熱ヒータ13を内蔵し、被処理基板、例えば半導体ウェハを載置する加熱基板12と、駆動機構（図示省略）により上下移動するベローズ14と、このベローズ14の上面に設けられ、加熱基板12に穿設された複数個、例えば3個の貫通孔12aにそれぞれ挿通したピン14aと、加熱基板12周縁部に沿って、約等しい幅、例えば約2mm幅を持って設けられる、不活性ガスの吹き出し孔32を形成するための、ガイドリング33とにより概略構成されている。

【0021】上述したピン14aは、ベローズ14の上面の上下移動でベローズ14上面が最上位になった時は、ピン14aの上端は加熱基板12上面より突出する。この状態で、ロボットアーム（図示省略）による半導体ウェハ10の搬入搬出が行われる。一方、ベローズ14の上面の上下移動で最下位になった時は、ピン14aの上端は貫通孔12a内に没入し、ピン14a上端に支持された半導体ウェハ10は矢印Aの下方に移動して

加熱基板12上面に載置され、半導体ウェハ10の加熱処理が開始状態となる。なお、ベローズ14の上面に設けられ3個のピン14aは、従来例と同様な平面的配置（図5参照）になっている。

【0022】加熱部5aのN₂ガスのガス配管系31には、流量調整器、例えばMFC（マスフローコントローラ）34とN₂ガスを加熱するガス加熱器35が設けられていて、処理室11に導入するN₂ガスのガス流量とガス温度を調整している。このN₂ガスは、処理室11の下方に設けられたガス配管15より処理室11内に導入され、加熱基板12周縁部とガイドリング33間に設けられた吹き出し孔32より加熱基板12の上方に吹き出される。ガイドリング33上面位置が加熱基板12上面位置より上方に位置するガイドリング33形状と、半導体ウェハ10中央部の上方に位置する排気口16との関係で、吹き出し孔32より吹き出されたN₂ガスの流れは、半導体ウェハ10の中央上方に向かう。従って半導体ウェハ10周辺部は、この加熱されたN₂ガスからの熱供給を受けるので、従来のような加熱基板12のみによる半導体ウェハ10の温度不均一性を補償し、半導体ウェハ10の温度均一化が可能となる。

【0023】次に、PEB装置の冷却部5bは、図2に示すように、処理室部40と、処理室21内の雰囲気を入換する不活性ガス、例えばN₂ガスを導入するための、不活性ガスを導入するガス配管系41とで概略構成されている。冷却部5bの処理室部40は、処理室21内に、冷却水が流れる中空部23を持ち、この中空部23に冷却水の配管24が接続する冷却基板22と、駆動機構（図示省略）により上下移動するベローズ25と、このベローズ25の上面に設けられ、冷却基板22に穿設された複数個、例えば、3個の貫通孔22aにそれぞれ挿通したピン25aと、冷却基板22周縁部に沿って、略等しい幅、例えば約2mm幅で設けられる、不活性ガスの吹き出し孔42を形成するための、ガイドリング43とにより概略構成されている。ベローズ14上面に穿設したピン25aが、冷却基板22上面より突出した状態で、ロボットアームにより送られてきた、加熱された半導体ウェハ10がピン25a上端に載置され、ベローズ25の下方への移動により、半導体ウェハ10は矢印Bの下方に移動して冷却基板22上に載置され、冷却開始状態となる。

【0024】冷却部5bのN₂ガスのガス配管系41には、流量調整器、例えばMFC（マスフローコントローラ）44とN₂ガスを冷却するガス冷却器45が設けられていて、処理室21に導入するN₂ガスのガス流量とガス温度を調整している。このN₂ガスは、処理室21の下方に設けられたガス配管26より処理室21内に導入され、冷却基板22周縁部とガイドリング43間に設けられた吹き出し孔42より冷却基板22の上方に吹き出される。ガイドリング43上面位置が冷却基板22上

面位置より上方に位置するガイドリング 4 3 形状と、半導体ウェハ 1 0 中央部の上方に位置する排気口 2 7 との関係で、吹き出し孔 4 2 より吹き出された N_2 ガスの流れは、半導体ウェハ 1 0 の中央上方に向かう。従って半導体ウェハ 1 0 周辺部は、この冷却された N_2 ガスへ熱を放出するので、従来のような冷却基板 2 2 のみによる半導体ウェハ 1 0 の温度不均一性を補償し、半導体ウェハ 1 0 の温度均一化が可能となる。

【0025】次に、上述した PEB 装置 5 を用いたベーキング方法を説明する。半導体装置製造のレジスト工程において、半導体ウェハ 1 0 に化学増幅型レジストが塗布され、ベレバークされ、A r F エキシマレーザ露光装置等により露光された半導体ウェハ 1 0 は、自動搬送により、PEB 装置 5 に送られる。この半導体ウェハ 1 0 は、PEB 装置 5 部のロボットアームによって、PEB 装置 5 部の加熱部 5 a に移動し、ベローズ 1 4 上面に穿設したピン 1 4 a 上端に載置される。なお、図面は省略したが、半導体ウェハ 1 0 をロボットアームにより搬入搬出する搬入搬出口は、ロボットアームが半導体ウェハ 1 0 を移動させる時以外は閉じた状態となっている。

【0026】ピン 1 4 a 上端に載置された半導体ウェハ 1 0 は、駆動機構（図示省略）により上下移動するベローズ 1 4 の移動で、矢印 A の下方に移動して加熱基板 1 2 上面に載置され、半導体ウェハ 1 0 の加熱処理が開始する。なお、この加熱基板 1 2 は加熱ヒータ 1 3 により、前もって所定の温度、例えば 110°C に加熱しておき、処理室 1 1 内にはガス流量とガス温度が調整された N_2 ガスが導入されている状態になっている。このガス流量としては、例えば 2000 sccm とし、ガス温度としては、例えば 115°C とする。

【0027】加熱基板 1 2 上面に載置された半導体ウェハ 1 0 は、所定時間、例えば 9 0 秒経過後、ベローズ 1 4 の移動で矢印 A の上方に移動して、その後直ちに、ロボットアームにより、半導体ウェハ 1 0 を捉えられて PEB 装置 5 部の冷却部 5 b に移動し、ベローズ 2 5 上面に穿設したピン 2 5 a 上端に載置される。ピン 2 5 a 上端に載置された半導体ウェハ 1 0 は、駆動機構（図示省略）により上下移動するベローズ 2 5 の移動で、矢印 A の下方に移動して冷却基板 2 2 上面に載置され、半導体ウェハ 1 0 の冷却処理が開始する。なお、この冷却基板 2 2 は冷却水により、前もって所定の温度、例えば 25°C に設定しておき、処理室 2 1 内にはガス流量とガス温度が調整された N_2 ガスが導入されている状態になっている。このガス流量としては、例えば 2000 sccm とし、ガス温度としては、例えば 22°C とする。

【0028】冷却基板 2 2 上に載置された半導体ウェハ 1 0 は、半導体ウェハ 1 0 の温度が冷却されて室温程度となる時間経過後、半導体ウェハ 1 0 をロボットアームで捉えて、レジスト工程の現像部に向かう自動搬送系に送り出す。

【0029】上述した PEB 工程でのベーキング装置およびベーキング方法を用いれば、化学増幅型レジストが塗布され、露光された後のベーキング工程で、半導体ウェハ 1 0 全面はほぼ同一の所定熱履歴による熱処理を受けることになり、露光により生成された酸を触媒とした、PEB 工程での熱処理による化学反応は、半導体ウェハ 1 0 面内の露光された部分で均一に起こることになる。従って、パターンニングされた線幅の半導体ウェハ 1 0 面内ばらつきが、ほとんど無いパターンニングが可能となる。

【0030】なお、上述した PEB 工程でのベーキング装置は、加熱部 5 a と冷却部 5 b の何れも半導体ウェハ 1 0 周辺部の温度補償のための、流量と温度を制御した不活性ガス導入方法を採用のものとしたが、冷却部 5 b の冷却基板 2 2 上における半導体ウェハ 1 0 の温度均一性の影響は少ないので、加熱部 5 a は上述した構成とし、冷却部 5 b は従来例の冷却部 5 b（図 6 参照）の構成としたベーキング装置であってもよい。

【0031】以上、本発明を実施の形態例により説明したが、本発明はこの実施の形態例に何ら限定されるものではない。例えば、不活性ガスとして、 N_2 ガスを用いたが、 He ガスや N_2 ガスと He ガスとの混合ガスを用いてもよい。また、被処理基板として半導体ウェハを用いて説明したが、石英やガラス等の絶縁体基板であってもよい。その他、本発明の技術的思想の範囲内で、PEB 工程のプロセス条件は適宜変更が可能である。

【0032】

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明の PEB 工程におけるベーキング装置およびベーキング方法は、半導体ウェハ 1 0 全面がほぼ同一の所定熱履歴による熱処理を受けることになり、露光により生成された酸を触媒とした、PEB 工程での熱処理による化学反応は、半導体ウェハ 1 0 面内の露光された部分で均一に起こることになる。従って、化学増幅型レジストを用いた微細化したパターンは、半導体ウェハ 1 0 面内での線幅バラツキがほとんど無い状態で形成でき、高集積化した半導体装置の製造が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明を適用した PEB 装置の加熱部の概略図である。

【図 2】本発明を適用した PEB 装置の冷却部の概略図である。

【図 3】従来のレジスト工程を説明する、レジスト工程の装置のブロック図である。

【図 4】従来の PEB 装置の加熱部の概略図である。

【図 5】従来の PEB 装置の加熱部の加熱基板に半導体ウェハを載置した状態での、加熱基板の上面図である。

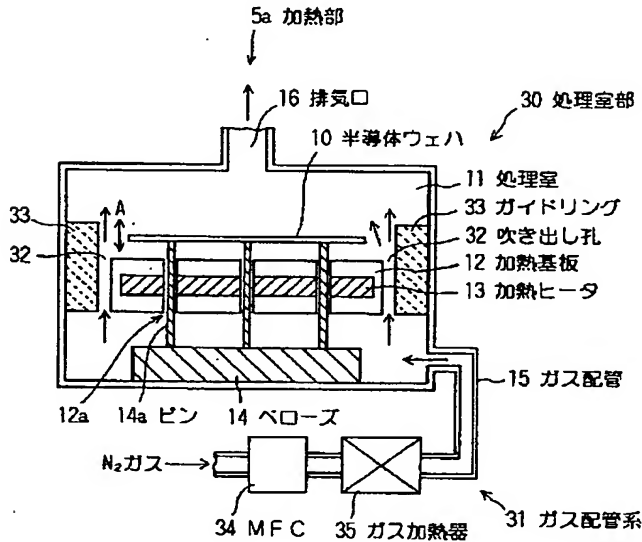
【図 6】従来の PEB 装置の冷却部の概略図である。

【符号の説明】

1…ウェハ供給部、2…レジスト塗布部、3…プリペー

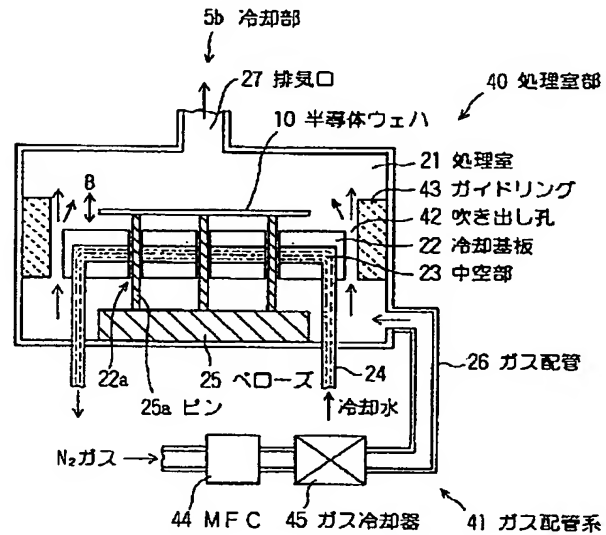
ク部、4…露光装置、5…PEB装置、5a…加熱部、5b…冷却部、6…現像部、7…ポストベーク部、8…ウェハ収納部、10…半導体ウェハ、11、21…処理室、12…加熱基板、12a、22a…貫通孔、13…加熱ヒータ、14、25…ベローズ、14a、25a…

【図1】

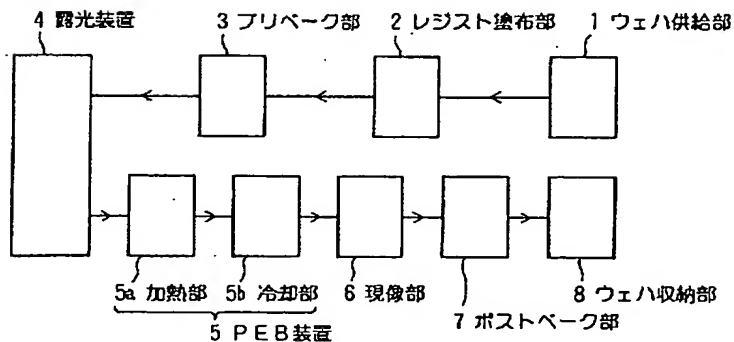


ピン、15、26…ガス配管、16、27…排気口、22…冷却基板、23…中空部、24…配管、30、40…処理室部、31、41…ガス配管系、32、42…吹き出し孔、33、43…ガイドリング、34、44…MFC、35…ガス加熱器、45…ガス冷却器

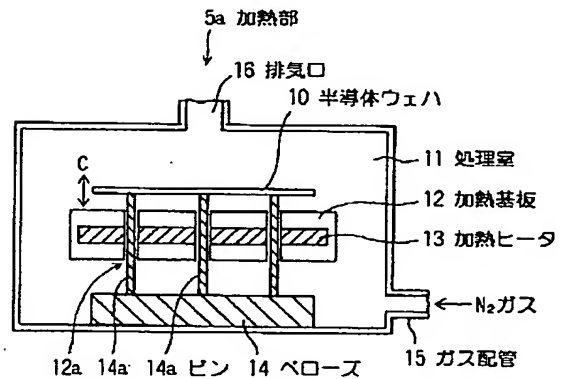
【図2】



【図3】



【図4】



【図 6】

